

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年1月12日(12.01.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/281584 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) *G03F 7/037* (2006.01)
G03F 7/027 (2006.01) *G03F 7/26* (2006.01)
G03F 7/033 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/025320

(22) 国際出願日: 2021年7月5日(05.07.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 昭和電工マテリアルズ株式会社 (SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 青木 優(AOKI Yu); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 濱野芳美(HAMANO Yoshimi); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 輝昭(SUZUKI Teruaki); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PERMANENT RESIST, METHOD FOR FORMING PERMANENT RESIST, AND METHOD FOR INSPECTING PERMANENT RESIST CURED FILM

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、永久レジスト、永久レジストの形成方法、及び永久レジスト用硬化膜の検査方法

(57) **Abstract:** An aspect of the present disclosure relates to a method for forming a permanent resist, said method comprising: a step for forming a resin film by coating and drying, on the entire surface or a portion of the surface of a substrate, a photosensitive resin composition comprising a base polymer and a compound that has an absorption peak at 360-500 nm and emits light upon irradiation with light; a step for exposing at least a portion of the resin film; a step for forming a patterned resin film by developing the resin film after exposure; and a step for heating the patterned resin film.

(57) 要約: 本開示の一側面は、ベースポリマーと、360~500nmに吸収ピークを有し光照射により発光する化合物と、を含有する感光性樹脂組成物を、基板の一部又は全面に塗布及び乾燥し樹脂膜を形成する工程と、樹脂膜の少なくとも一部を露光する工程と、露光後の樹脂膜を現像してパターン樹脂膜を形成する工程と、パターン樹脂膜を加熱する工程と、を備える、永久レジストの形成方法に関する。

WO 2023/281584 A1